

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称及人员姓名	UBS、Barings、Grand Alliance Asset Management、Harbourview、Lazard Asset Management、Millennium Partners、Oberweis、Open Door Capital、Point 72、Shikhara、Toroa Management、WIM Investment Management Limited、WT Asset Management、BlackRock、Ariose Capital、BNP Paribas Asset Management、Newton Investment Management、GIC、Polymer、中信证券、中银资管、国投瑞银基金、上银基金、国海证券、国寿资产、东方财富证券、兆顺基金
会议时间	2026年1月12日、1月13日
会议地点	上海、公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：孙凯 证券事务代表：彭芹芹
投资者关系活动主要内容介绍	Q1、如何看待锂电领域业务增长的持续性？ A1、去年以来，下游锂电领域景气度显著回升，公司与下游众多核心客户建立了长期稳定的合作，并紧跟客户产品升级与设备更新需求，持续强化产品竞争力，稳固市场优势地位。叠加储能市场快速增长、行业技术迭代等因素驱动，行业景气度有望持续。 Q2、请介绍下公司半导体领域业务和布局。

A2、在功率半导体领域，公司有超声波端子焊接机、超声波PIN针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货，与上汽英飞凌、中车时代、振华科技、宏微科技、士兰微、芯联集成、华润微等知名企业保持良好合作。在半导体先进封装领域，公司大力推动先进超声波扫描显微镜以及超声波固晶机（超声热压焊机）等新产品设备的研发和推广，其中可应用于半导体晶圆级封装、2.5D/3D封装、面板级封装等产品检测的先进超声波扫描显微镜，成功获得了国内知名客户正式订单并完成交付；超声波固晶机（超声热压焊机）已获得客户正式订单。公司先进封装相关业务正持续突破技术与市场边界，加速向规模化应用迈进。

Q3、公司在液冷板领域的应用是什么？

A3、公司自主研发的超声波扫描显微镜可用于液冷板的内部缺陷检测。在液冷板领域，公司超声波扫描显微镜通过水浸方式将超声波传递到被检材料中，根据超声波向被检材料发射与接收信号幅值的变化程度，来辨别缺陷位置及大小，可以检测液冷板内部的焊缝裂纹、夹杂、虚焊、未焊合等多种缺陷。

Q4、关于线束领域业务有何展望？

A4、在线束连接器领域，公司产品广泛应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能等领域，比如新能源汽车连接线、充电桩连接线、超充连接线、储能场景等。公司在现有优势产品基础上，积极把握下游市场对高电压、大电流等技术升级带来的新需求，持续拓展线束连接器超声波设备种类覆盖范围。随着下游汽车电动化与智能化、新能源、数据中心等应用行业需求增长，为上游超声波设备厂商提供了良好的发展机遇。

Q5、是否还有其他应用布局？

A5、公司紧跟技术迭代与市场需求趋势，逐步拓展超声波技术新的应用。公司自主研发的超声波扫描显微镜，已广泛应用于新能源电池、液冷板、半导体芯片、晶圆等关键工件的内部

	<p>缺陷检测；在航空航天领域，公司针对碳纤维复合材料的增减材制造与检测需求积极推进相关产品开发与落地，加速技术向实际应用转化。公司坚持超声波核心技术，通过持续完善超声波技术平台，快速把握下游新能源、半导体、医疗及新兴行业等领域的市场机遇，促进公司业务实现长远发展。</p> <p>Q6、公司是否有计划进行海外业务拓展？</p> <p>A6、公司已组建了海外团队，同时公司部分产品经过在客户处的长期验证，技术及性能等均达到甚至超越国际竞争对手的水平，公司能够为客户提供具有较高的性价比和优质服务的解决方案。公司将积极拓展海外市场比如欧洲地区，将成熟先进的产品比如线束连接器超声波设备、半导体超声波设备等推向海外市场，实现海外业务不断拓展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年1月13日